

Projektmeldung | Taiwan | Maschinen- und Anlagenbau

02.07.2020

Erweiterung der Produktionskapazität für 12-Zoll-Wafer-Fabriken

Planungsstadium

Land:	Taiwan
Finanzierung:	Privater Sektor
Kategorie:	Maschinen- und Anlagenbau
Träger:	Winbond

Der taiwanische Halbleiterhersteller Winbond wird seine Produktionskapazität für 12-Zoll-Wafer-Fabriken erweitern und die Technologie aktualisieren. Die Produktanwendungen werden Automobilindustrie, industrielle Fertigung, Medizin, künstliche Intelligenz, 5G, Internet der Dinge und andere aufstrebende Branchen sein. Investitionen in Höhe von 210 Mio. US-Dollar sind geplant.

Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt aufzurufen

Klicken Sie auf den Button "My GTAI Login" und loggen Sie sich mit Ihrer Benutzererkennung ein. Sollten Sie für diese Webseite noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich hier schnell **KOSTENLOS REGISTRIEREN**

[My GTAI Login](#)

Dieser Inhalt ist relevant für:

Taiwan
Maschinen- und Anlagenbau / Photonik, Elektronische Bauelemente
Projekte

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch teilweise – nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.

© 2020 Germany Trade & Invest

Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.